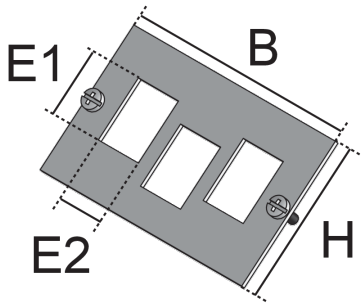


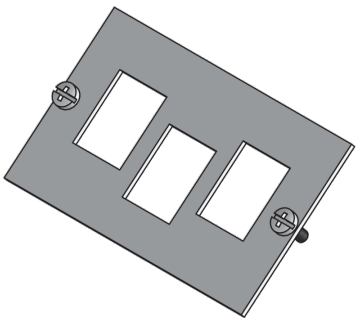
UDEP RMSC 3

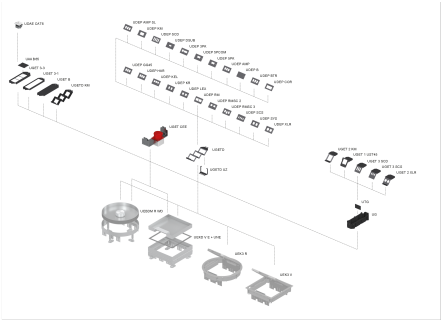
Einbauplatine, Datentechnik

Bei den Bauelementen UDEP RMSC 3 handelt es sich um Einbauplatinen aus dem Sortiment der Unterflursysteme. Die Platinen werden in Datengeräteträger eingeschraubt und dienen dort zur Aufnahme von bis zu 3 Snap-in-Datenjacks des Herstellers R&M. Die Einbauplatinen sind aus einseitig schwarz beschichtetem Aluminium gefertigt und können mit dem Einbaumaß E1 von 19.5 mm und E2 von 14.9 mm erworben werden.

Artikel	Typ	H	B	Datenjacks	E1	E2	Farbe	G
UDEP-RMSC 3	Einbauplatine,	46 mm	75 mm	3	19.5 mm	14.9 mm	Schwarz	0.014 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER





OPTIONALES ZUBEHÖR

UGETD

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 21.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten